

中国国际金融股份有限公司
关于长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二六年五月

声 明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐人”或“中金公司”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况	3
(一) 发行人基本信息.....	3
(二) 发行人主营业务.....	3
(三) 发行人核心技术与研发水平.....	5
(四) 发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标.....	6
(五) 发行人存在的主要风险.....	6
二、发行人本次发行情况	6
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	15
(一) 项目保荐代表人保荐业务主要执业情况.....	15
(二) 项目协办人保荐业务主要执业情况.....	16
(三) 项目组其他成员情况.....	16
四、保荐机构与发行人之间的关联关系	16
五、保荐机构承诺事项	18
六、本次发行履行了必要的决策程序	18
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见	20
(一) 发行人符合科创板定位的理由和依据.....	20
(二) 保荐机构核查情况.....	22
八、保荐机构对发行人是否符合科创板上市条件的说明	23
(一) 符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件.....	23
(二) 发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元.....	26
(三) 公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上	26
(四) 市值及财务指标符合上市规则规定的标准.....	27
(五) 上海证券交易所规定的其他上市条件.....	27
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排	27
十、保荐机构认为应当说明的其他事项	28
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论	28

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称	长鑫科技集团股份有限公司
英文名称	CXMT Corporation
注册资本	6,019,279.7469 万元
法定代表人	赵纶
成立日期	2016 年 6 月 13 日
整体变更为股份公司日期	2023 年 6 月 27 日
公司住所	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
邮政编码	230088
电话号码	0551-67189988
传真号码	0551-67189889
互联网网址	https://www.cxmt.com/
电子邮箱	ir@cxmt.com
信息披露和投资者关系负责部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	袁园（董事会秘书）
信息披露和投资者关系负责人电话	0551-67189988

（二）发行人主营业务

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。根据 Omdia 的数据，按出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。

DRAM 是现代信息技术和数字信息产业发展的重要基石，广泛应用于数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等领域。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。同时，公司积极把握行业发展趋势，持续进行产品迭代，现已形成 DDR 系列、LPDDR 系列等多元化产品

布局，并可提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。

我国是全球最大的 DRAM 需求市场之一，而全球前三家 DRAM 厂商三星电子、SK 海力士和美光科技长期占全球 90% 以上的市场份额。公司致力于持续扩充产能，不断提升全球市场份额，并为我国 DRAM 市场提供稳定的供应。公司在合肥、北京两地共拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂，产能规模位居中国第一、全球第四。

公司高度重视技术创新与先进工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了经验丰富的研发团队，承担多项国家重大专项课题。通过持续不断的研发投入与技术创新，公司已形成多项科研成果，并在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完善的核心技术体系，主要核心技术已达到国际先进水平。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。根据世界知识产权组织的统计数据，公司 2023 年国际专利申请公开数量排名全球第 22 位；根据美国权威专利服务机构 IFI 公布的数据，公司 2024 年美国专利授权排名全球第 42 位，在所有上榜的中国企业中排名第四。

作为 DRAM 产业龙头企业，经过长期发展，公司已与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。公司在服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等各大领域积累了广泛的优质客户资源，建立了良好的品牌效应。公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，持续赢得客户的肯定和赞誉。此外，公司积极与半导体存储设计企业、EDA 厂商、材料厂商、设备及零部件厂商、存储模组厂商等紧密合作，共同推动我国 DRAM 市场发展和产业生态的完善。随着公司现有产能逐步释放以及规划建设产能逐步完成，公司将持续提升市场份额，以存储科技赋能信息社会，成为技术领先与商业成功的半导体存储企业。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,953,128.56	31.87%	317,397.33	13.26%	182,716.69	20.16%
LPDDR 系列	4,070,354.50	66.43%	1,979,825.86	82.74%	675,607.25	74.54%
其他产品及服务	104,054.15	1.70%	95,651.94	4.00%	47,990.43	5.30%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

（三）发行人核心技术与研发水平

1、核心技术

公司采用 IDM 模式运营，核心技术能力主要体现在工艺技术和产品技术两大方面，领先的产品技术是公司快速响应市场，持续进行产品优化升级、不断推陈出新的重要基础，工艺技术是公司产品技术得以有效实现商业化应用的重要支撑，也是公司产品质量、性能和成本持续改善的重要保障，工艺技术和产品技术相辅相成，共同构筑了公司的核心技术竞争力。

公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造，通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术，覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。公司核心技术主要为自主研发形成，公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台，并已大量应用于公司产品的大批量生产中。

2、研发水平

报告期各期，公司研发费用分别为 452,047.07 万元、460,728.35 万元和 959,325.46 万元，研发费用率分别为 49.75%、19.06%和 15.52%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 6,259 人，员工总数为 19,298 人，公司研发人员占比达到 32.43%。

公司核心技术人员共 5 名，分别为曹堪宇、李红文、TAN TECK HONG（陈德鸿）、王丹、唐衍哲。公司高度重视对研发人才、核心技术人才的长期激励，通过目标管理和考核机制、市场化的薪酬机制及股权长期激励机制等，促进研发与技术团队骨干成员的稳定，并激励其不断进取、持续创新。

作为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业，公司在相关业务领域具有强大的科研实力和技术创新能力，并长期承担及参与各类重大科研项目。报告期内，公司参与了多项重大科研项目。

(四) 发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

项目	2025年12月31日/ 2025年度	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额（万元）	33,678,492.22	27,159,883.10	19,275,633.28
归属于母公司所有者权益（万元）	5,675,370.42	4,141,966.16	3,559,534.99
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
资产负债率（母公司）	21.82%	10.26%	8.69%
营业收入（万元）	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
净利润（万元）	714,423.71	-905,100.04	-1,922,488.63
归属于母公司所有者的净利润（万元）	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38
基本每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
稀释每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
加权平均净资产收益率	3.83%	-17.54%	-38.28%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入比例	15.52%	26.23%	51.40%

(五) 发行人存在的主要风险

1、存在累计未弥补亏损的风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计亏损为-3,665,042.11 万元，最近一年末存在累计未弥补亏损的主要原因系：（1）DRAM 行业具有规模导向属性。为增强产品的市场占有率和竞争力，公司需要持续提升产能规模，而厂房及产线建设等需要高额的固定资产投资，对应固定资产折旧金额较大。报告期内，公司处于产能快速爬坡阶段，产线持续建设并不断升级，相关资产转固后产生的折旧等固定成本较高且金额持续增加。虽然公司于 2024 年息税折旧摊销前利润转正，但新增产能带来的规模效应尚未完全显现；

（2）DRAM 行业具有极高的技术门槛，公司持续进行产品和工艺技术的研发迭代，以尽快实现对国际先进水平的追赶、提升产品竞争力并满足市场需求，报告期内研发投入持续增加。

公司未来几年内持续扩产及投入研发带来的折旧及摊销、研发支出等在短期内仍将

给公司利润带来压力，如果未来公司出现产品研发及市场化不及预期、规模效应释放不及预期等情况，将可能导致公司持续处于存在未弥补亏损的状态，对公司的盈利能力带来一定不利影响，并导致短期内无法向股东进行现金分红。

2、产品及技术研发不达预期的风险

DRAM 行业属技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，产品终端应用场景丰富，产品升级和迭代速度较快。DRAM 行业的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，研发周期较长。多年来，公司坚持自主研发的道路，通过研发与创新形成了现有核心技术平台。若公司研发方向与市场需求出现偏差、新产品技术性能落后于竞争对手或技术研发和产品升级不及预期，导致公司未来不能紧跟行业前沿和市场需求，则可能对公司未来的经营带来不利影响。

3、人才短缺或流失的风险

公司所处 DRAM 行业属于人才密集型行业。从 DRAM 研发到生产、销售及运营管理的各个环节，都需要相关人员具备扎实的专业基础以及长期的经验积累。优秀的行业人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司获得持续竞争优势的重要保障。

公司组建了具备丰富半导体行业经验的技术研发及运营管理团队，在 DRAM 产品设计、工艺开发、生产制造、质量管控、运营管理等方面具备深厚的技术积累和丰富的经验。公司高度重视对人才的管理，制定了完善的人才及薪酬管理体系，采取股权激励等多样化的方式，有效绑定并吸引优秀人才。近年来在国家政策的支持下，集成电路企业数量高速增长，半导体行业人才需求与日俱增，优秀行业人才供不应求。未来，如果公司无法持续吸引和绑定优秀人才，可能导致公司核心人才流失，进而影响公司重要研发与创新活动的开展，对公司未来业务发展产生不利影响。

4、技术泄密及知识产权保护、纠纷风险

经过多年来持续的技术积累，公司掌握了多项与 DRAM 相关的核心技术，涵盖 DRAM 产品设计、制造、封测及模组设计与应用等多个环节，并形成了大量生产工艺方面的技术诀窍（Know-How）、专利、集成电路布图设计等知识产权。一直以来，公司重视对核心技术的保护，制定了完善的信息保密制度，并与相关技术人员在劳动合同、保密协议中约定了相应职务发明和作品权属、保密及竞业条款等。但受技术保密手段的固有局限性、核心人才流动风险及其他外部不可控因素影响，未来公司仍可能因核心技

术人员流失、信息保管不善、外界窃取等原因导致公司核心技术泄露，以及不排除在未来业务开展过程中与竞争对手产生技术及知识产权相关的纠纷、争议或诉讼的可能，从而对公司市场竞争力和生产经营带来不利影响。

5、客户集中度较高的风险

报告期各期，发行人主营业务中向前五大客户合计销售额占当期主营业务收入的比例分别为 74.12%、67.30%和 68.08%，直接客户主要为半导体行业知名经销商，终端客户主要为服务器、移动设备、个人电脑等下游应用领域的大型厂商，包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等。公司客户集中度相对偏高，主要由于公司下游服务器、移动设备、个人电脑等市场需求相对较大且市场相对集中，同时公司主要通过经销模式由少量经销商对接终端客户所致。如果未来主要客户的市场需求受外部负面因素影响出现大幅下滑，将可能对公司持续经营能力及未来业绩的成长性构成一定不利影响。

6、主营业务毛利率存在波动的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为-2.19%、5.00%和 41.02%。报告期内，一方面，受公司持续进行大额固定资产及研发投入带来的折旧及摊销金额较高、规模效应尚未完全显现等因素影响，公司产品生产成本较高，另一方面，公司工艺技术水平等与三星电子、SK 海力士及美光科技相比仍有一定差距，产品结构处于持续优化状态，公司毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低。此外，叠加 DRAM 行业周期导致产品价格变动，报告期内公司毛利率存在一定波动。

若未来存储芯片市场价格出现下滑且公司规模效应长期无法显现，公司毛利率可能面临下滑的风险，从而对公司未来持续经营能力产生不利影响。

7、固定资产投资及折旧金额较大的风险

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 8,445,207.29 万元、15,313,201.60 万元和 18,302,398.79 万元，占期末资产总额的比例分别为 43.81%、56.38%和 54.34%，占比较高且金额持续增加。报告期内各期计提固定资产折旧额分别为 1,055,525.26 万元、1,487,543.58 万元、2,468,025.21 万元，呈现上升趋势。公司还在进行持续产能建设，固定资产账面价值预计将进一步增加，其产生的大额折旧将在折旧期限内对公司业绩带来一定影响。同时，公司固定资产可能由于发生毁损、技术升级迭代或路线变化等原因，

出现固定资产减值的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。

8、研发投入较大、无形资产摊销金额较大及减值的风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期内累计研发投入为 2,060,501.67 万元，占累计营业收入的 21.67%，研发投入强度较高。报告期内各期计提无形资产摊销额分别为 134,301.92 万元、143,190.66 万元、167,542.57 万元，呈现上升趋势。报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为 15,000.00 万元、173,400.78 万元和 0 万元，研发支出资本化比例分别为 3.21%、27.34% 和 0，研发支出资本化及形成的自研无形资产金额和摊销金额均较大。如果公司受研发进展不及预期、相关技术发生颠覆性变革或者市场需求发生重大变化等不利因素影响，可能导致公司相关无形资产面临较大的减值风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

9、存货跌价风险

报告期内，随着销售规模的稳步增长，公司各期末原材料、在产品及产成品的存货余额亦呈增长趋势，各期末存货余额分别为 1,418,047.50 万元、2,121,450.87 万元和 2,938,989.52 万元，各期末计提的存货跌价准备分别为 344,429.77 万元、266,497.91 万元和 82,220.84 万元。集成电路行业存在周期特征，宏观经济、行业景气度以及产能周期等因素均会对行业产生重要影响，报告期各期，公司存货跌价损失分别为-1,150,021.06 万元、-182,688.41 万元和-47,314.97 万元，受 DRAM 行业周期的影响较大，尤其是 2023 年，DRAM 行业周期下行带来存货跌价损失计提大幅增加。未来，如果行业周期、市场需求或公司产品的市场价格发生变化，使得部分存货的售价不能覆盖成本，公司将面临存货跌价增加的风险，进而对公司资产价值及盈利能力产生不利影响。

10、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-727,162.07 万元、689,745.85 万元和 3,651,981.33 万元；公司各期末现金及现金等价物余额分别为 3,111,261.16 万元、4,250,821.86 万元和 3,779,781.08 万元。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024 年实现转正并于 2025 年大幅增长，未来如果公司经营情况或外部行业及市场出现波动且不能得到持续改善，公司的营运资金周转将存在一定的流动性风险，公司业务发展可能会受到制约。

11、对重要子公司长鑫新桥和长鑫集电持股比例较低的风险

截至本上市保荐书出具之日，长鑫新桥、长鑫集电为发行人重要子公司。发行人及子企业直接持有长鑫新桥 30.68%的股权，并通过与鑫益合升、合肥产投一致行动协议控制长鑫新桥 42.33%的表决权，合计控制长鑫新桥 73.01%的表决权，可以控制长鑫新桥。发行人直接持有长鑫集电 31.72%的股权，并通过与屹唐科技、亦庄科技、亦庄国投一致行动协议控制长鑫集电 43.60%的表决权，合计控制长鑫集电 75.32%的表决权，可以控制长鑫集电。上述长鑫新桥、长鑫集电少数股东与发行人及子企业签署的一致行动协议长期有效。若一致行动协议的有效履行情况在未来发生不利变化，导致发行人实际控制长鑫新桥、长鑫集电的表决权比例下降，发行人对长鑫新桥、长鑫集电控制的稳定性可能存在一定风险，会对公司业务开展及经营管理造成不利影响。

12、无控股股东和实际控制人的风险

根据公司股权结构，直接持有公司 5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，分别持有长鑫科技 21.67%、11.71%、8.73%、8.37%及 7.91%的股权，不存在单一持股比例超过 50%的股东，公司的股权结构较为分散。其中，公司第一大股东清辉集电系无实际控制人结构。根据公司董事会构成，公司董事会由 11 名成员构成，其中独立董事 4 名。7 名非独立董事中，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

由于公司无控股股东和实际控制人，可能会出现股东或董事意见不一致导致决策效率较低从而错失发展机遇的风险。同时，公司的股权结构相对分散，存在上市后控制权发生变动的可能性，从而给公司经营和发展稳定带来潜在的风险。

13、环境保护的风险

公司在生产经营中会产生废水、废气和固体废物，需遵守环境保护方面的相关法律法规。公司根据相关规定，积极履行环保职责，完善环保措施，制定了严格的环保制度，但未来如果公司由于环保设施运行故障等原因发生环境污染事件，可能受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。同时，如果国家或各地出台更为严格的环保要求，公司或需投入相应资金对现有环保设施进行升级改造。

14、安全生产的风险

公司生产涉及部分机械设备操作且所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。公司高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，对操作人员进行了严格的培训，建立了科学的安全生产管理体系。但未来如果公司在安全生产管理制度上出现漏洞、管理不规范或生产人员在生产过程中未严格按照安全生产制度进行生产作业等，则公司存在发生安全生产事故，导致员工伤亡、财产损失、产线停工及受到相关部门行政处罚的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

15、人工智能发展是驱动本轮 DRAM 行情的重要因素之一，未来其带来的 DRAM 市场需求存在不确定性

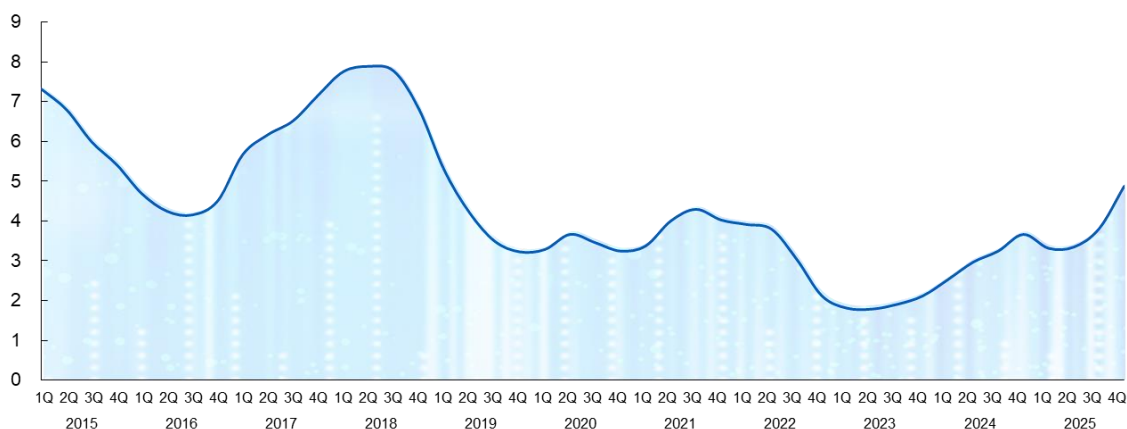
DRAM 是人工智能算力系统的核心枢纽，随着人工智能快速发展，相关基础设施投资高速增长。2025 年下半年以来，受人工智能发展带来的 DRAM 需求增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，带动 DRAM 产品价格上涨，是 2025 年下半年以来公司业绩增长的主要原因之一。

当前人工智能产业正处于基础设施集中投资建设期，但其商业化应用仍处于持续拓展过程中，公司报告期内相关领域内的收入占比相对较低。倘若未来人工智能规模化应用落地不及预期或头部云厂商资本开支节奏放缓，可能会对 DRAM 市场未来需求增长带来不利影响；同时，伴随人工智能模型算法持续优化，存算一体、片上缓存等新型硬件架构与技术方案也在持续探索中。前述技术路线若实现大规模产业化应用，可能改变现有以云端 GPU/AI 加速卡集群搭配 DRAM 的主流算力部署方式，削弱人工智能对 DRAM 市场的驱动作用。当前全球主要 DRAM 厂商均在积极进行技术升级和扩充产能，后续若人工智能对 DRAM 需求不及预期，叠加新产能的释放，或将导致供过于求，进而致使公司业绩下行。

16、宏观经济波动和行业周期性导致公司产品销售价格及经营业绩波动的风险

DRAM 行业受市场供需波动的影响较大，具有周期性特征，同时，宏观经济波动、高行业集中度下主要厂商的产能调控策略等因素进一步加剧了行业周期性波动。2015 年-2025 年间，DRAM 产品价格最高达到 7.89 美元/GB，2023 年上半年的最低点为 1.78 美元/GB，DRAM 市场价格呈现大幅波动。

2015-2025 年 DRAM 市场价格（美元/GB）



数据来源：Omdia

报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为-1,633,977.72 万元、-714,488.72 万元和 187,485.94 万元，经营业绩的波动一方面得益于规模效应逐步释放及精益生产管理，另一方面受行业周期影响较大。2022 年至 2023 年上半年，受上游 DRAM 产品库存水平较高、下游市场需求低迷的影响，DRAM 行业处于深度下行周期，DRAM 产品的销售价格大幅下滑，价格低点较 2022 年上半年高点下降 50% 左右，该轮行业周期内，行业内企业出现普遍性亏损情况。下行周期会对公司产品价格和经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司主要的 DRAM 产品销售单价在行业周期的影响下波动较大，2024 年和 2025 年，公司主要 DRAM 产品销售单价的同比变动幅度分别为 55.08% 和 33.69%。2025 年下半年，受人工智能发展带来的 DRAM 需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，成为公司产品单价和毛利率提升以及业绩增长的重要原因之一，但未来人工智能发展对 DRAM 市场需求存在不确定性。未来，如果宏观经济发生不利变化、人工智能下游需求不及预期、市场供需关系发生较大变化，可能导致 DRAM 行业再次进入下行周期，可能导致公司产品价格出现大幅下跌，业绩出现大幅下滑乃至亏损，2026 年上半年的业绩大幅增长的情况存在不可持续的风险。

17、国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

经过多年发展，半导体产业链已形成高度专业化和高效协同的全球分工体系，但当前地缘政治冲突正加速产业链重构。尽管公司自成立以来始终坚持市场化运营，自觉遵

守国际间有关进出口相关规则 and 规定，但如短期内相关国家进一步加强限制政策，可能导致公司面临产业链不稳定的风险，进而对公司的生产和经营活动造成一定不利影响。

18、市场竞争风险

从行业发展历史来看，DRAM 行业自 20 世纪 80 年代发展初期的数十家企业，发展到三星电子、SK 海力士及美光科技三家国际 DRAM 厂商长期占全球 90%以上的市场份额，当前市场呈现高度集中格局。与国际头部厂商相比，公司在整体规模、技术积累、客户资源等方面仍然存在一定差距。

DRAM 市场具备大宗商品属性及强周期性特点，在激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握产业迭代和技术发展趋势，及时跟进市场需求进行技术升级、产能调控、提高产品性能与服务质量，则难以在高度集中的市场中维持可持续的竞争力，进而对公司未来的业务前景和市场地位造成不利影响。

19、募集资金投资项目实施不及预期的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前中国境内外市场环境、行业发展趋势和技术水平等因素作出的。但上述项目需要一定的建设周期，一旦市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大变化，项目在实施过程中可能受到市场环境、产业政策以及项目管理、产品及服务市场销售状况等变化因素的不利影响，将影响项目的实施进度，致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异，面临募集资金投资项目实施效果不及预期的风险。

20、募投项目新增费用及折旧摊销影响公司经营业绩的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建设期间，公司新增相关费用投入；本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产的投入将导致相应的折旧、摊销费用增加，对发行人各年度经营业绩有直接影响。由于募投项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种不确定性，若未来发行人所处市场环境等因素发生重大不利变化，导致募集资金投资项目无法实现预计效益，则前述新增的折旧摊销、期间费用等可能影响公司利润，从而导致未来经营业绩存在下降的风险。

21、发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对行业及公司价值判断等多种内外部因素的影响。公司股票发行价格确定后，若发行人网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向上交所备案，方可重新启动发行。若公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次公开发行不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	本次公开发行不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 7,081,505.7468 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）	发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		

发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
募集资金总额	根据询价后确定的价格乘以发行股数确定
募集资金净额	由募集资金总额扣除发行费用后确定
募集资金投资项目	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目
	DRAM 存储器技术升级项目
	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销费及保荐费【】万元 （2）审计、验资费【】万元 （3）律师费【】万元 （4）评估费【】万元 （5）其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，发行人将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行上市战略配售，具体按照交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行上市战略配售的具体方案，并按规定向交易所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

魏先勇：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾经担任华润微科创板 IPO 项目、中芯国际科创板 IPO 项目、龙迅股份科创板 IPO 项目、阿特斯科创板 IPO 项目、中远海控非公开发行项目、华润微非公开发行项目等项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严

格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

田桂宁：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：吴迪，于 2009 年取得证券从业资格，曾经参与华润微科创板 IPO 项目、中芯国际科创板 IPO 项目、东微半导体科创板 IPO 项目、龙迅股份科创板 IPO 项目、新相微科创板 IPO 项目、阿特斯科创板 IPO 项目、华润微非公开发行项目等多个项目。

（三）项目组其他成员情况

项目组其他成员：刘飞峙、刘剑峰、胡璇、熊峰、叶建冬、杨妍、余朝辉、李开洲、吴家腾、于宁、杨箭宇、杨森、张文。

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）中金公司及其下属企业持有发行人或其重要关联方股份的情况如下：

1、截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人中金公司全资子公司中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）是中金共赢的执行事务合伙人，同时直接以及通过中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启融”）合计持有中金共赢 56.3534% 财产份额，中金共赢直接持有发行人 19,041.98 万股股份，占发行人股份总数的 0.32%；

2、截至 2025 年 12 月 31 日，中金资本是中金启融的执行事务合伙人且持有 0.04% 合伙份额，中金启融是北京君联的有限合伙人，持有其 1.99% 的合伙份额，北京君联直接持有发行人 11,774.27 万股股份，占发行人股份总数的 0.20%；

3、截至 2025 年 12 月 31 日，发行人股东华芯科泰的股权向上逐层穿透后，存在中金公司及其下属企业间接持股的情况，间接持有发行人的股份比例合计为 0.0007%。

中金公司作为长鑫科技本次首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，严格遵守相关法律法规及监管要求，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。中金公司建立并实施包括《限制名单政策》在内的信息隔离墙制度，在制度上确保各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管

理等方面的独立隔离机制及保密信息的妥善管理,以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行。通过上述路径持有发行人股份的中金公司相关主体的对外投资依据其独立投资研究决策或者根据相关法律法规执行的投资,与本次保荐项目并无关联。

中金公司将安排相关子公司参与本次发行的战略配售,具体按照上交所相关规定执行。中金公司及其相关子公司后续将按照要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件。

除上述情形外,截至本上市保荐书出具之日,本保荐机构自身及下属子公司不存在持有发行人或其重要关联方股份的情况。

(二)发行人及其重要关联方不存在持有本保荐机构及本保荐机构下属子公司股份的情况。

(三)本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员,不存在持有发行人或其重要关联方股份,以及在发行人或其重要关联方任职的情况。

(四)中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”),截至2025年12月31日,中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权,同时,中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司共持有中金公司约0.06%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司,中央汇金根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料,中金公司上级股东单位与发行人及其重要关联方之间不存在相互持股的情况,中金公司上级股东单位与发行人或其重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

(五)本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

本保荐机构依据相关法律法规和公司章程,独立公正地履行保荐职责。

五、保荐机构承诺事项

(一) 中金公司承诺已按照法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

(二) 作为长鑫科技本次发行的保荐机构，中金公司作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

六、本次发行履行了必要的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》、上海证券交易所及中国证监会规定的决策程序，具体如下：

2025年9月10日，发行人召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于公司申请首次公开发行股票

募集资金用途的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》《关于填补首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》《关于制订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于制定或修订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关内控规则和制度的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》《关于确认最近三年一期关联交易和董监高获授予激励股份的议案》等，就本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东会审议。

2025年9月25日，发行人召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》《关于填补首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》《关于制订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于制定或修订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关内控规则和制度的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》《关于确认最近三年一期关联交易和董监高获授予激励股份的议案》等，就决议的有效期及对董事会办理本次发行具体事宜的授权等事项进行了决议，并批准了本次发行。

综上，保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》以及中国证监会和上交所规定的决策程序。

七、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见

（一）发行人符合科创板定位的理由和依据

1、发行人符合科创板支持方向

（1）发行人符合国家科技创新战略

公司主营业务为 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，是中国领先的 DRAM 研发设计制造一体化企业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所从事的行业为“制造业”(C)之“计算机、通信和其他电子设备制造业”(39)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2024 年 4 月修订)，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域。

集成电路是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。DRAM 作为集成电路产业发展的战略基础性产品，是数字经济时代的核心芯片，也是国家信息基础设施战略安全的重要基石。公司所属 DRAM 行业属于国家高度重视和鼓励发展的战略性新兴产业之一，是《国家信息化发展战略纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》重点支持的战略产业。

（2）发行人拥有关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营

公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造，通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术，覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

公司核心技术主要为自主研发形成，公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台，并已大量应用于公司产品的大批量生产中。

发行人自主研发并持续积累形成的核心技术广泛应用于公司各类主营业务产品及服务，报告期内，发行人核心技术产生的收入占营业收入的比例均超过 98%。

（3）发行人科技创新能力及科研成果转化运用能力突出

公司组建了经验丰富的研发团队，通过持续高效的研发创新机制，形成了现有核心

技术体系，在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节掌握了一系列关键核心技术，并已大量应用于公司产品的批量生产中。

公司始终坚持以市场为导向，持续进行技术开拓创新和产品研发升级，并积累了一系列先进、创新的科技成果。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。公司凭借 DRAM 设计与制造领域的深厚技术积累，积极推进工艺技术和产品技术的开发与产业化，实现了科技成果与产业的深度融合。

报告期内，公司核心技术产品广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场，并与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，实现了核心技术的产业落地。

（4）发行人行业地位突出且市场认可度高

长鑫科技是全球主流 DRAM 市场的重要竞争者，也是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。基于 Omdia 全球厂商 2025 年第四季度 DRAM 销售额测算，公司全球市场占有率为 7.67%，位列全球第四位，中国第一位。

（5）发行人及所处行业具备较强的成长性

作为数字经济时代新型信息基础设施的核心组成部分，DRAM 在现代信息社会中扮演着战略性基础设施的重要角色，是全球半导体市场占比最高的单一品类之一。根据世界半导体贸易统计协会 WSTS 统计，2025 年全球集成电路市场规模为 7,009 亿美元，占半导体产业整体规模的比例约为 88%，其中，全球存储芯片市场规模为 2,300 亿美元，占集成电路市场规模的比例约为 33%。根据 Omdia 和 WSTS 数据，DRAM 是市场规模最大的存储芯片，2025 年全球 DRAM 市场规模为 1,505 亿美元，占存储芯片市场规模的比例约为 65%。

近年来，新兴技术场景持续涌现，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求驱动全球 DRAM 市场规模快速扩大。长期来看，全球 DRAM 市场仍有广阔的增长空间。根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2025 年的 1,505 亿美元增长至 2030 年的 5,710 亿美元，年均复合增长率为 30.56%。

中国 DRAM 市场覆盖国内消费电子市场与电子信息制造业的广泛需求，在全球 DRAM 市场中占据重要份额。根据 Yole 数据，2024 年中国 DRAM 市场规模约为 250 亿美元，占全球 DRAM 市场规模的比重超过四分之一。作为全球主要的 DRAM 需求市场，中国在该领域长期高度依赖进口，DRAM 本土厂商仍有广阔的市场空间。

2、发行人符合科技创新行业领域要求

公司所属科技创新行业领域见下表：

发 行 人 所 属 行 业 领 域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主要从事 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，是中国领先的 DRAM 研发设计制造一体化企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所从事的行业为“制造业”(C)之“计算机、通信和其他电子设备制造业”(39)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2024 年 4 月修订)，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

3、发行人符合科创属性相关指标或情形

科创属性评价指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年，公司研发投入分别为 467,047.07 万元、634,129.13 万元、959,325.46 万元，合计研发投入金额 2,060,501.67 万元，超过 8,000 万元；发行人最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 21.67%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 6,259 人，员工总数为 19,298 人，公司研发人员占比达到 32.43%，研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有境内专利 3,929 件（其中发明专利 3,165 件）、境外专利 3,043 件，并广泛应用于公司主营业务，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年，公司营业收入复合增长率为 160.78%，超过 25%；公司 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，超过 3 亿元

(二) 保荐机构核查情况

1、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

(1) 查阅行业法律法规及国家政策文件，分析公司是否符合国家科技创新战略的相关要求；实地查看公司主要经营场地并了解公司提供的主要产品和服务，对比公司所处行业与相关科创板及战略性新兴产业行业范围；

(2) 向公司管理层及业务人员了解公司所处的行业、主要经营的业务以及相关的行业上下游情况；公司各产品平台核心技术的内容、关键性能指标以及在生产经营中的具体运用等，比较分析公司主要产品关键性能指标与同行业公司同类产品的差异，了解公司技术及产品的先进性；

(3) 向公司管理层及业务人员了解公司先进技术应用形成的产品及产业化情况，公司保持技术不断创新的机制安排，以及技术储备和新技术新产品的商业化情况；

(4) 查阅专业市场分析机构出具的行业分析报告，了解公司在各主营业务领域的行业地位和市场认可度，以及公司所处行业的市场规模、未来市场空间、下游应用领域发展趋势等；

(5) 获取公司参与的重要科研项目的相关凭证，及获得的重要奖项凭证等；

(6) 获取并审阅德勤出具的审计报告，获取并复核公司的研发投入归集明细情况，计算公司研发投入占比；

(7) 获取并了解公司研发部门设置情况及研发人员花名册；

(8) 获取并核查公司的专利注册证书，在裁判文书网、中国执行信息公开网检索公司涉及的诉讼等纠纷，向公司相关研发技术人员了解公司发明专利在主营业务及核心技术中的应用情况。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为：发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创板定位要求。

八、保荐机构对发行人是否符合科创板上市条件的说明

(一) 符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

保荐机构对发行人首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，结果如下：

1、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人设立至今相关的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商设立及变更登记文件、股本变动涉及的增减资协议、股权变动涉及的股权转让协议、股权转让款支付凭证、主要资产权属证明、相关董事会和股东会决议文件、发起人和主要股东的营业执照（或身份证明文件）、发行人开展生产经营所需的业务许可证照或批准等文件资料；对发行人、主要股东进行了访谈，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询和会议讨论。发行人前身合肥智聚成立于 2016 年 6 月 13 日。2023 年 6 月 27 日，发行人由睿力集成按原账面净资产折股整体变更设立股份有限公司。截至本上市保荐书出具之日，发行人的持续经营时间在三年以上。发行人符合《注册管理办法》第十条的规定：“发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。”

2、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）、《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551 号）、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》（证监会公告[2013]46 号）等法规的要求对发行人的财务会计进行了尽职调查，调查过程包括但不限于：对经审计的财务报告及经审核的内部控制鉴证报告以及其他相关财务资料进行了审慎核查；就发行人报告期内收入构成变动、主营业务成本构成分析及变动、销售费用、管理费用和研发费用构成及变化、财务指标和比率变化等与同期相关行业、市场和可比公司情况进行了对比分析；查阅了报告期内重大购销合同、主要税种纳税资料以及税收优惠或财政补贴资料，并走访了银行等部门；就发行人财务会计问题，本保荐机构与发行人财务人员和审计师进行密切沟通，并召开了多次专题会议。发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定：“发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效

率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。”

3、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的独立性进行了尽职调查，调查过程包括但不限于：核查了发行人的组织结构资料及发行人实际控制人的身份证明文件，调阅了发行人的重大采购、销售合同，访谈了发行人主要客户、供应商；核查了发行人主要经营性资产的权属证明和实际使用情况；核查了发行人员工名册及劳务合同；核查了发行人的财务管理制度、银行开户资料和纳税资料；核查了发行人相关三会决议和内部机构规章制度；就发行人业务、财务和机构、人员的独立性，对发行人、主要股东进行了访谈，并向发行人律师、会计师进行了专项咨询和会议讨论。发行人符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定：“资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。”

4、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的规范运行进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：查阅了发行人的公司章程、董事会和股东会议事规则和相关会议文件资料、董事会专门委员会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则；取得了发行人的书面声明和相关政府部门出具的证明；查阅了发行人内部审计等内部规章制度；核查了发行人管理层对内控制度的自我评估意见和会计师的鉴证意见；向董事、独立董事、董事会秘书、高管人员进行了访谈；向发行人律师、审计师进行了专项咨询和会议讨论。发行人符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定：“主营业务、控制权和管理团队稳定，首次公开发行股票并在主板上市的，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；首次公开发行股票并在科创板、创业板上市的，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；首次公开发行股票并在科创板上市的，核心技术人员应当稳定且最近二年内没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，首次公开发行股票并在主板上市的，最近三年实际控制人没有发生变更；首次公开发行股票并在科创板、创业板上市的，最近二年实际控制人没有发生变更。”

5、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的资产完整性进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人主要资产权属证明、发行人开展

生产经营所需的业务许可证照或批准等文件资料；对于发行人资产完整性进行了网络公开核查；对发行人、主要股东等进行了访谈，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询和会议讨论。发行人符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定：“不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

6、本保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的业务合规性及相关主体满足发行条件进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人开展生产经营所需的业务许可证照或批准等文件资料并获取了主管部门开具的合规证明；对发行人、主要股东、董事、高级管理人员等进行了访谈，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询和会议讨论。发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定：“发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近三年内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。董事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。”

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前股本总额为 6,019,279.75 万元，本次拟发行股份不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），大于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”的规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上

经核查，发行人本次发行前股本总额为 6,019,279.75 万元，超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），本次公开发行的股份达到公司股份总数的 10% 以上。符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上”的规定。

（四）市值及财务指标符合上市规则规定的标准

公司主要从事 DRAM 产品研发、设计、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为“制造业”（C）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）。经核查，公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”。

发行人 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司的估值情况，发行人预计将满足《上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准。

（五）上海证券交易所规定的其他上市条件

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

首次公开发行股票并在科创板上市的，持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构将继续完成。

本保荐机构在持续督导期间，将履行下列持续督导职责：

- 1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度；
- 2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见；
- 3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照规定履行核查、信息披露等义务；
- 4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告；
- 5、定期出具并披露持续督导跟踪报告；
- 6、中国证监会、上海证券交易所规定或者保荐协议约定的其他职责。

本保荐机构、保荐代表人将针对上市公司的具体情况，制定履行各项持续督导职责的实施方案。

十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

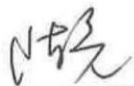
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构中金公司认为，发行人长鑫科技集团股份有限公司申请其股票上市符合《证券法》《上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上交所科创板上市的条件，同意推荐发行人在上交所科创板上市。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书》之签章页)

法定代表人:



陈亮

2026年5月27日

保荐业务负责人:



孙雷

2026年5月27日

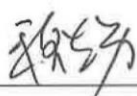
内核负责人:



章志皓

2026年5月27日

保荐代表人:



魏先勇



田桂宁

2026年5月27日

项目协办人:



吴迪

2026年5月27日

保荐人公章

中国国际金融股份有限公司



2026年5月27日

中信建投证券股份有限公司

关于

长鑫科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人董军峰、廖小龙已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义	3
一、发行人基本情况	5
二、发行人本次发行情况	17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	20
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	20
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明	21
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	22
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明	26
九、持续督导期间的工作安排	29
十、保荐人关于本项目的推荐结论	30

释 义

本上市保荐书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

保荐人、本保荐人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
上市保荐书、本上市保荐书	指	《中信建投证券股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
长鑫科技、公司、发行人	指	长鑫科技集团股份有限公司
本项目	指	长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目
睿力集成	指	睿力集成电路有限公司，发行人前身
合肥智聚	指	合肥智聚集成电路有限公司，发行人前身
长鑫集成	指	合肥长鑫集成电路有限责任公司
清辉集电	指	合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）
合肥集鑫	指	合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
安徽省投	指	安徽省投资集团控股有限公司
鑫芯励润	指	合肥鑫芯励润科技合伙企业（有限合伙）
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市
德勤、发行人会计师	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、报告期各期	指	2023年度、2024年度及2025年度
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《长鑫科技集团股份有限公司章程（草案）》，于2025年9月25日经发行人2025年第三次临时股东大会会议审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市挂牌交易之日起生效
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国法律、行政法规、地方性法规、部门规章以及规范性文件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，上下文另有说明的除外
存储芯片	指	存储芯片是半导体存储器，用于在电子设备中保存和读取数据，分为易失型存储和非易失型存储
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，是一种半导体存储器，需要周期性刷新以维持其存储的数据
DDR	指	Double Data Rate，即双倍速率同步动态随机存储器，指数据传输速度为系统时钟频率的两倍。DDR、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5 分别代表不同代际的 DDR 技术
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate，即低功耗双倍速率同步动态随机存储器，以低功耗和小体积著称，主要用于移动式电子产品；LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、LPDDR6 分别代表不同代际的 LPDDR 技术
Gb、GB	指	为计算机存储容量单位，Gb 指 Gigabit，GB 指 Giga Byte，1GB=8Gb
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指垂直整合制造工厂，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商，属于半导体行业的一种业务模式

注：本上市保荐书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本上市保荐书中所列示的相关单项数据计算得出的结果在尾数上略有不同。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称	长鑫科技集团股份有限公司
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
成立时间	2016 年 6 月 13 日
注册资本	6,019,279.7469 万元
法定代表人	赵纶
董事会秘书	袁园
联系电话	0551-67189988
互联网地址	https://www.cxmt.com/
主营业务	长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 的产品覆盖和迭代，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。根据 Omdia 的数据，按出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。

DRAM 是现代信息技术和数字信息产业发展的重要基石，广泛应用于数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等领域。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。同时，公司积极把握行业发展趋势，持续进行产品迭代，现已形成 DDR 系列、

LPDDR 系列等多元化产品布局，并提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。

我国是全球最大的 DRAM 需求市场之一，而全球前三家 DRAM 厂商三星电子、SK 海力士和美光科技长期占全球 90% 以上的市场份额。公司致力于持续扩充产能，不断提升全球市场份额，并为我国 DRAM 市场提供稳定的供应。公司在合肥、北京两地共拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂，产能规模位居中国第一、全球第四。

公司高度重视技术创新与先进工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了经验丰富的研发团队，承担多项国家重大专项课题。通过持续不断的研发投入与技术创新，公司已形成多项科研成果，并在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完善的核心技术体系，主要核心技术已达到国际先进水平。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。根据世界知识产权组织的统计数据，公司 2023 年国际专利申请公开数量排名全球第 22 位；根据美国权威专利服务机构 IFI 公布的数据，公司 2024 年美国专利授权排名全球第 42 位，在所有上榜的中国企业中排名第四。

作为 DRAM 产业龙头企业，经过长期发展，公司已与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。公司在服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等各大领域积累了广泛的优质客户资源，建立了良好的品牌效应。公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，持续赢得客户的肯定和赞誉。此外，公司积极与半导体存储设计企业、EDA 厂商、材料厂商、设备及零部件厂商、存储模组厂商等紧密合作，共同推动我国 DRAM 市场发展和产业生态的完善。随着公司现有产能逐步释放以及规划建设产能逐步完成，公司将持续提升市场份额，以存储科技赋能信息社会，成为技术领先与商业成功的半导体存储企业。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,953,128.56	31.87%	317,397.33	13.26%	182,716.69	20.16%
LPDDR 系列	4,070,354.50	66.43%	1,979,825.86	82.74%	675,607.25	74.54%
其他产品及服务	104,054.15	1.70%	95,651.94	4.00%	47,990.43	5.30%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

2、发行人核心技术

公司采用 IDM 模式运营，核心技术能力主要体现在工艺技术和产品技术两大方面，领先的产品技术是公司快速响应市场，持续进行产品优化升级、不断推陈出新的重要基础，工艺技术是公司产品技术得以有效实现商业化应用的重要支撑，也是公司产品质量、性能和成本持续改善的重要保障，工艺技术和产品技术相辅相成，共同构筑了公司的核心技术竞争力。

公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造，通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术，覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。公司核心技术主要为自主研发形成，公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台，并已大量应用于公司产品的大批量生产中。

3、发行人研发水平

报告期各期，公司研发费用分别为 452,047.07 万元、460,728.35 万元和 959,325.46 万元，研发费用率分别为 49.75%、19.06%和 15.52%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 6,259 人，员工总数为 19,298 人，公司研发人员占比达到 32.43%。

公司核心技术人员共 5 名，分别为曹堪宇、李红文、TAN TECK HONG（陈德鸿）、王丹、唐衍哲。公司高度重视对研发人才、核心技术人才的长期激励，通过目标管理和考核机制、市场化的薪酬机制及股权长期激励机制等，促进研发

与技术团队骨干成员的稳定，并激励其不断进取、持续创新。

作为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业，公司在相关业务领域具有强大的科研实力和技术创新能力，并长期承担及参与各类重大科研项目。报告期内，公司参与了多项重大科研项目。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2025年12月31日/ 2025年度	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额（万元）	33,678,492.22	27,159,883.10	19,275,633.28
归属于母公司所有者权益（万元）	5,675,370.42	4,141,966.16	3,559,534.99
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
资产负债率（母公司）	21.82%	10.26%	8.69%
营业收入（万元）	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
净利润（万元）	714,423.71	-905,100.04	-1,922,488.63
归属于母公司所有者的净利润（万元）	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38
基本每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
稀释每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
加权平均净资产收益率	3.83%	-17.54%	-38.28%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入比例	15.52%	26.23%	51.40%

（四）发行人存在的主要风险

1、存在累计未弥补亏损的风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计亏损为-3,665,042.11 万元，最近一年未存在累计未弥补亏损的主要原因系：（1）DRAM 行业具有规模导向属性。为增强产品的市场占有率和竞争力，公司需要持续提升产能规模，而厂房及产线建设等需要高额的固定资产投资，对应固定资产折旧金额较大。报告期内，公司处于产能快速爬坡阶段，产线持续建设并不断升级，相关资产转固后产生的折旧等固

定成本较高且金额持续增加。虽然公司于 2024 年息税折旧摊销前利润转正，但新增产能带来的规模效应尚未完全显现；（2）DRAM 行业具有极高的技术门槛，公司持续进行产品和工艺技术的研发迭代，以尽快实现对国际先进水平的追赶、提升产品竞争力并满足市场需求，报告期内研发投入持续增加。

公司未来几年内持续扩产及投入研发带来的折旧及摊销、研发支出等在短期内仍将给公司利润带来压力，如果未来公司出现产品研发及市场化不及预期、规模效应释放不及预期等情况，将可能导致公司持续处于存在未弥补亏损的状态，对公司的盈利能力带来一定不利影响，并导致短期内无法向股东进行现金分红。

2、产品及技术研发不达预期的风险

DRAM 行业属技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，产品终端应用场景丰富，产品升级和迭代速度较快。DRAM 行业的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，研发周期较长。多年来，公司坚持自主研发的道路，通过研发与创新形成了现有核心技术平台。若公司研发方向与市场需求出现偏差、新产品技术性能落后于竞争对手或技术研发和产品升级不及预期，导致公司未来不能紧跟行业前沿和市场需求，则可能对公司未来的经营带来不利影响。

3、人才短缺或流失的风险

公司所处 DRAM 行业属于人才密集型行业。从 DRAM 研发到生产、销售及运营管理的各个环节，都需要相关人员具备扎实的专业基础以及长期的经验积累。优秀的行业人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司获得持续竞争优势的重要保障。

公司组建了具备丰富半导体行业经验的技术研发及运营管理团队，在 DRAM 产品设计、工艺开发、生产制造、质量管控、运营管理等方面具备深厚的技术积累和丰富的经验。公司高度重视对人才的管理，制定了完善的人才及薪酬管理体系，采取股权激励等多样化的方式，有效绑定并吸引优秀人才。近年来在国家政策的支持下，集成电路企业数量高速增长，半导体行业人才需求与日俱增，优秀行业人才供不应求。未来，如果公司无法持续吸引和绑定优秀人才，可

能导致公司核心人才流失，进而影响公司重要研发与创新活动的开展，对公司未来业务发展产生不利影响。

4、技术泄密及知识产权保护、纠纷风险

经过多年来持续的技术积累，公司掌握了多项与 DRAM 相关的核心技术，涵盖 DRAM 产品设计、制造、封测及模组设计与应用等多个环节，并形成了大量生产工艺方面的技术诀窍（Know-How）、专利、集成电路布图设计等知识产权。一直以来，公司重视对核心技术的保护，制定了完善的信息保密制度，并与相关技术人员在劳动合同、保密协议中约定了相应职务发明和作品权属、保密及竞业条款等。但受技术保密手段的固有局限性、核心人才流动风险及其他外部不可控因素影响，未来公司仍可能因核心技术人员流失、信息保管不善、外界窃取等原因导致公司核心技术泄露，以及不排除在未来业务开展过程中与竞争对手产生技术及知识产权相关的纠纷、争议或诉讼的可能，从而对公司市场竞争力和生产经营带来不利影响。

5、客户集中度较高的风险

报告期各期，发行人主营业务中向前五大客户合计销售额占当期主营业务收入的比例分别为 74.12%、67.30%和 68.08%，直接客户主要为半导体行业知名经销商，终端客户主要为服务器、移动设备、个人电脑等下游应用领域的大型厂商，包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等。公司客户集中度相对偏高，主要由于公司下游服务器、移动设备、个人电脑等市场需求相对较大且市场相对集中，同时公司主要通过经销模式由少量经销商对接终端客户所致。如果未来主要客户的市场需求受外部负面因素影响出现大幅下滑，将可能对公司持续经营能力及未来业绩的成长性构成一定不利影响。

6、主营业务毛利率存在波动的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为-2.19%、5.00%和 41.02%。报告期内，一方面，受公司持续进行大额固定资产及研发投入带来的折旧及摊销金额较高、规模效应尚未完全显现等因素影响，公司产品生产成本较高，另一方面，公司工艺技术水平等与三星电子、SK 海力士及美光科技相比仍有一定差距，产品

结构处于持续优化状态，公司毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低。此外，叠加 DRAM 行业周期导致产品价格变动，报告期内公司毛利率存在一定波动。

若未来存储芯片市场价格出现下滑且公司规模效应长期无法显现，公司毛利率可能面临下滑的风险，从而对公司未来持续经营能力产生不利影响。

7、固定资产投资及折旧金额较大的风险

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 8,445,207.29 万元、15,313,201.60 万元和 18,302,398.79 万元，占期末资产总额的比例分别为 43.81%、56.38% 和 54.34%，占比较高且金额持续增加。报告期内各期计提固定资产折旧额分别为 1,055,525.26 万元、1,487,543.58 万元、2,468,025.21 万元，呈现上升趋势。公司还在进行持续产能建设，固定资产账面价值预计将进一步增加，其产生的大额折旧将在折旧期限内对公司业绩带来一定影响。同时，公司固定资产可能由于发生毁损、技术升级迭代或路线变化等原因，出现固定资产减值的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。

8、研发投入较大、无形资产摊销金额较大及减值的风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期内累计研发投入为 2,060,501.67 万元，占累计营业收入的 21.67%，研发投入强度较高。报告期内各期计提无形资产摊销额分别为 134,301.92 万元、143,190.66 万元、167,542.57 万元，呈现上升趋势。报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为 15,000.00 万元、173,400.78 万元和 0 万元，研发支出资本化比例分别为 3.21%、27.34% 和 0，研发支出资本化及形成的自研无形资产金额和摊销金额均较大。如果公司受研发进展不及预期、相关技术发生颠覆性变革或者市场需求发生重大变化等不利因素影响，可能导致公司相关无形资产面临较大的减值风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

9、存货跌价风险

报告期内，随着销售规模的稳步增长，公司各期末原材料、在产品及产成品的存货余额亦呈增长趋势，各期末存货余额分别为 1,418,047.50 万元、2,121,450.87 万元和 2,938,989.52 万元，各期末计提的存货跌价准备分别为 344,429.77 万元、266,497.91 万元和 82,220.84 万元。集成电路行业存在周期特征，

宏观经济、行业景气度以及产能周期等因素均会对行业产生重要影响，报告期各期，公司存货跌价损失分别为-1,150,021.06 万元、-182,688.41 万元和-47,314.97 万元，受 DRAM 行业周期的影响较大，尤其是 2023 年，DRAM 行业周期下行带来存货跌价损失计提大幅增加。未来，如果行业周期、市场需求或公司产品的市场价格发生变化，使得部分存货的售价不能覆盖成本，公司将面临存货跌价增加的风险，进而对公司资产价值及盈利能力产生不利影响。

10、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-727,162.07 万元、689,745.85 万元和 3,651,981.33 万元；公司各期末现金及现金等价物余额分别为 3,111,261.16 万元、4,250,821.86 万元和 3,779,781.08 万元。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024 年实现转正并于 2025 年大幅增长，未来如果公司经营情况或外部行业及市场出现波动且不能得到持续改善，公司的营运资金周转将存在一定的流动性风险，公司业务发展可能会受到制约。

11、对重要子公司长鑫新桥和长鑫集电持股比例较低的风险

截至本上市保荐书出具之日，长鑫新桥、长鑫集电为发行人重要子公司。发行人及子企业直接持有长鑫新桥 30.68%的股权，并通过与鑫益合升、合肥产投一致行动协议控制长鑫新桥 42.33%的表决权，合计控制长鑫新桥 73.01%的表决权，可以控制长鑫新桥。发行人直接持有长鑫集电 31.72%的股权，并通过与屹唐科技、亦庄科技、亦庄国投一致行动协议控制长鑫集电 43.60%的表决权，合计控制长鑫集电 75.32%的表决权，可以控制长鑫集电。上述长鑫新桥、长鑫集电少数股东与发行人及子企业签署的一致行动协议长期有效。若一致行动协议的有效履行情况在未来发生不利变化，导致发行人实际控制长鑫新桥、长鑫集电的表决权比例下降，发行人对长鑫新桥、长鑫集电控制的稳定性可能存在一定风险，会对公司业务开展及经营管理造成不利影响。

12、无控股股东和实际控制人的风险

根据公司股权结构，直接持有公司 5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，分别持有长鑫科技 21.67%、11.71%、

8.73%、8.37%及 7.91%的股权，不存在单一持股比例超过 50%的股东，公司的股权结构较为分散。其中，公司第一大股东清辉集电系无实际控制人结构。根据公司董事会构成，公司董事会由 11 名成员构成，其中独立董事 4 名。7 名非独立董事中，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

由于公司无控股股东和实际控制人，可能会出现股东或董事意见不一致导致决策效率较低从而错失发展机遇的风险。同时，公司的股权结构相对分散，存在上市后控制权发生变动的可能性，从而给公司经营和发展稳定带来潜在的风险。

13、环境保护的风险

公司在生产经营中会产生废水、废气和固体废物，需遵守环境保护方面的相关法律法规。公司根据相关规定，积极履行环保职责，完善环保措施，制定了严格的环保制度，但未来如果公司由于环保设施运行故障等原因发生环境污染事件，可能受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。同时，如果国家或各地出台更为严格的环保要求，公司或需投入相应资金对现有环保设施进行升级改造。

14、安全生产的风险

公司生产涉及部分机械设备操作且所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。公司高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，对操作人员进行了严格的培训，建立了科学的安全生产管理体系。但未来如果公司在安全生产管理制度上出现漏洞、管理不规范或生产人员在生产过程中未严格按照安全生产制度进行生产作业等，则公司存在发生安全生产事故，导致员工伤亡、财产损失、产线停工及受到相关部门行政处罚的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

15、人工智能发展是驱动本轮 DRAM 行情的重要因素之一，未来其带来的 DRAM 市场需求存在不确定性

DRAM 是人工智能算力系统的核心枢纽，随着人工智能快速发展，相关基础设施投资高速增长。2025 年下半年以来，受人工智能发展带来的 DRAM 需求增

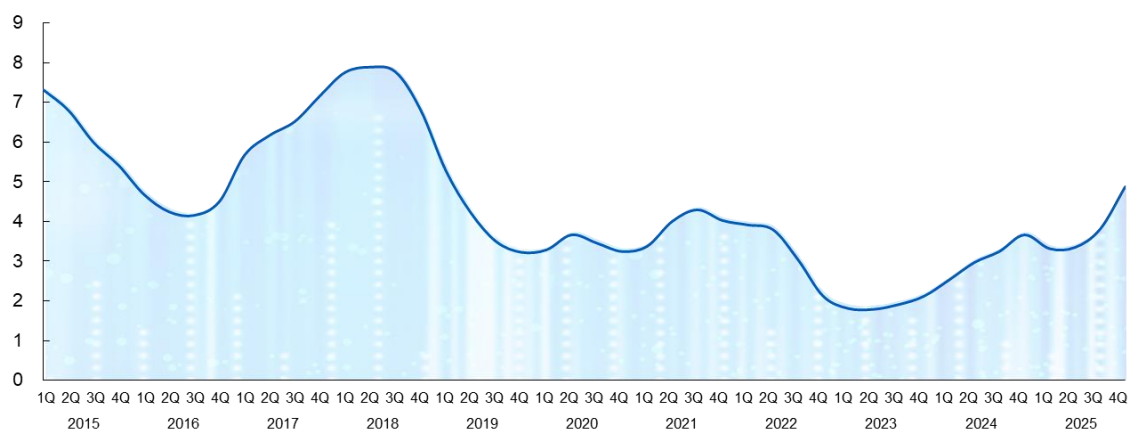
长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，带动 DRAM 产品价格上涨，是 2025 年下半年以来公司业绩增长的主要原因之一。

当前人工智能产业正处于基础设施集中投资建设期，但其商业化应用仍处于持续拓展过程中，公司报告期内相关领域内的收入占比相对较低。倘若未来人工智能规模化应用落地不及预期或头部云厂商资本开支节奏放缓，可能会对 DRAM 市场未来需求增长带来不利影响；同时，伴随人工智能模型算法持续优化，存算一体、片上缓存等新型硬件架构与技术方案的持续探索中。前述技术路线若实现大规模产业化应用，可能改变现有以云端 GPU/AI 加速卡集群搭配 DRAM 的主流算力部署方式，削弱人工智能对 DRAM 市场的驱动作用。当前全球主要 DRAM 厂商均在积极进行技术升级和扩充产能，后续若人工智能对 DRAM 需求不及预期，叠加新产能的释放，或将导致供过于求，进而致使公司业绩下行。

16、宏观经济波动和行业周期性导致公司产品销售价格及经营业绩波动的风险

DRAM 行业受市场供需波动的影响较大，具有周期性特征，同时，宏观经济波动、高行业集中度下主要厂商的产能调控策略等因素进一步加剧了行业周期性波动。2015 年-2025 年间，DRAM 产品价格最高达到 7.89 美元/GB，2023 年上半年的最低点为 1.78 美元/GB，DRAM 市场价格呈现大幅波动。

2015-2025 年 DRAM 市场价格（美元/GB）



数据来源：Omdia

报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为-1,633,977.72 万元、-714,488.72 万元和 187,485.94 万元，经营业绩的波动一方面得益于规模效应逐步释放及精益生产管理，另一方面受行业周期影响较大。2022 年至 2023 年上半年，受上游 DRAM 产品库存水平较高、下游市场需求低迷的影响，DRAM 行业处于深度下行周期，DRAM 产品的销售价格大幅下滑，价格低点较 2022 年上半年高点下降 50%左右，该轮行业周期内，行业内企业出现普遍性亏损情况。下行周期会对公司产品价格和经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司主要的 DRAM 产品销售单价在行业周期的影响下波动较大，2024 年和 2025 年，公司主要 DRAM 产品销售单价的同比变动幅度分别为 55.08% 和 33.69%。2025 年下半年，受人工智能发展带来的 DRAM 需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，成为公司产品单价和毛利率提升以及业绩增长的重要原因之一，但未来人工智能发展对 DRAM 市场需求存在不确定性。未来，如果宏观经济发生不利变化、人工智能下游需求不及预期、市场供需关系发生较大变化，可能导致 DRAM 行业再次进入下行周期，可能导致公司产品价格出现大幅下跌，业绩出现大幅下滑乃至亏损，2026 年上半年的业绩大幅增长的情况存在不可持续的风险。

17、国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

经过多年发展，半导体产业链已形成高度专业化和高效协同的全球分工体系，但当前地缘政治冲突正加速产业链重构。尽管公司自成立以来始终坚持市场化运营，自觉遵守国际间有关进出口相关规则和规定，但如短期内相关国家进一步加强限制政策，可能导致公司面临产业链不稳定的风险，进而对公司的生产和经营活动造成一定不利影响。

18、市场竞争风险

从行业发展历史来看，DRAM 行业自 20 世纪 80 年代发展初期的数十家企业，发展到三星电子、SK 海力士及美光科技三家国际 DRAM 厂商长期占全球

90%以上的市场份额，当前市场呈现高度集中格局。与国际头部厂商相比，公司在整体规模、技术积累、客户资源等方面仍然存在一定差距。

DRAM 市场具备大宗商品属性及强周期性特点，在激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握产业迭代和技术发展趋势，及时跟进市场需求进行技术升级、产能调控、提高产品性能与服务质量，则难以在高度集中的市场中维持可持续的竞争力，进而对公司未来的业务前景和市场地位造成不利影响。

19、募集资金投资项目实施不及预期的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前中国境内外市场环境、行业发展趋势和技术水平等因素作出的。但上述项目需要一定的建设周期，一旦市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大变化，项目在实施过程中可能受到市场环境、产业政策以及项目管理、产品及服务市场销售状况等变化因素的不利影响，将影响项目的实施进度，致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异，面临募集资金投资项目实施效果不及预期的风险。

20、募投项目新增费用及折旧摊销影响公司经营业绩的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建设期间，公司新增相关费用投入；本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产的投入将导致相应的折旧、摊销费用增加，对发行人各年度经营业绩有直接影响。由于募投项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种不确定性，若未来发行人所处市场环境等因素发生重大不利变化，导致募集资金投资项目无法实现预计效益，则前述新增的折旧摊销、期间费用等可能影响公司利润，从而导致未来经营业绩存在下降的风险。

21、发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对行业及公司价值判断等多种内外部因素的影响。公司股票发行价格确定后，若发行人网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监会予以注

册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向上交所备案，方可重新启动发行。若公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次公开发行不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	本次公开发行不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 7,081,505.7468 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）	发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	根据询价后确定的价格乘以发行股数确定		

募集资金净额	由募集资金总额扣除发行费用后确定
募集资金投资项目	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目
	DRAM 存储器技术升级项目
	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销费及保荐费【】万元 （2）审计、验资费【】万元 （3）律师费【】万元 （4）评估费【】万元 （5）其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，发行人将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行上市战略配售，具体按照交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行上市战略配售的具体方案，并按规定向交易所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定董军峰、廖小龙担任本次长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

董军峰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO 项目、恒玄

科技 IPO 项目、奇安信 IPO 项目、软通动力 IPO 项目、思特威 IPO 项目、云从科技 IPO 项目、南芯科技 IPO 项目、美芯晟 IPO 项目、颀中科技 IPO 项目、光线传媒 IPO 项目、上海贝岭并购重组项目、拓尔思并购重组项目等，目前无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。董军峰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

廖小龙先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：赛力斯 IPO 项目、云从科技 IPO 项目、颀中科技 IPO 项目、恒坤新材 IPO 项目、高德红外非公开发行股票项目、申菱环境非公开发行股票项目、小康股份公开发行可转债项目、颀中科技向不特定对象发行可转债项目、小康股份发行股份购买资产项目、国泰集团发行股份购买资产及配套融资项目、映日科技新三板挂牌项目等，目前无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。廖小龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行上市项目协办人

本次证券发行项目的协办人为汪鹏飞，其保荐业务执行情况如下：

汪鹏飞先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：炬光科技 IPO 项目、中国长城非公开发行股票项目、炬光科技跨境并购财务顾问项目、映日科技新三板挂牌项目等。汪鹏飞先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括胡家荣、谌泽昊、周岱岳、谭谷、梁文、魏潇天、王赛、程图展、吴建航、舒福星、张铁、钱堃。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
邮编：	100026

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系电话：	010-56051780
传真：	010-56160130

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）截至 2025 年 12 月 31 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司是合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有其 26.57% 的合伙份额，合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）是鑫芯励润的有限合伙人，持有其 52.34% 的合伙份额，而鑫芯励润直接持有发行人 63,977.53 万股股份，占发行人股份总数的 1.06%，逐层穿透后间接持有的发行人股份比例合计为 0.15%。除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其重要关联方股份的情况。本保荐人已建立有效的信息隔离墙管理制度，保荐人全资子公司中信建投投资有限公司间接持有发行人股份的情形不影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责；

此外，保荐人将根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定，安排相关子公司参与本次发行战略配售；

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在持有发行人或其重要关联方权益，或在发行人或其重要关联方任职等情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人或其重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问

题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

2025年9月10日，发行人召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首

次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

2025年9月25日，发行人召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）发行人符合板块定位及国家产业政策情况

1、发行人符合科创板支持方向

（1）发行人符合国家科技创新战略

公司主营业务为 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，是中国领先的 DRAM 研发设计制造一体化企业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为“制造业”（C）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域。

集成电路是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。DRAM 作为集成电路产业发展的战略基础性产品，是数字经济时代的核心芯片，也是国家信息基础设施战略安全的重要基石。公司所属 DRAM 行业属于国家高度重视和鼓励发展的战略性新兴产业之一，是《国家信息化发展战略纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十

五个五年规划纲要》重点支持的战略产业。

(2) 发行人拥有关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营

公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造,通过持续的研发投入与技术探索,已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术,覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

公司核心技术主要为自主研发形成,公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台,并已大量应用于公司产品的大批量生产中。

发行人自主研发并持续积累形成的核心技术广泛应用于公司各类主营业务产品及服务,报告期内,发行人核心技术产生的收入占营业收入的比例均超过 98%。

(3) 发行人科技创新能力及科研成果转化运用能力突出

公司组建了经验丰富的研发团队,通过持续高效的研发创新机制,形成了现有核心技术体系,在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节掌握了一系列关键核心技术,并已大量应用于公司产品的批量生产中。

公司始终坚持以市场为导向,持续进行技术开拓创新和产品研发升级,并积累了一系列先进、创新的科技成果。截至 2025 年 12 月 31 日,公司共拥有 3,929 项境内专利(其中发明专利 3,165 项)以及 3,043 项境外专利。公司凭借 DRAM 设计与制造领域的深厚技术积累,积极推进工艺技术和产品技术的开发与产业化,实现了科技成果与产业的深度融合。

报告期内,公司核心技术产品广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场,并与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作,实现了核心技术的产业落地。

(4) 发行人行业地位突出且市场认可度高

长鑫科技是全球主流 DRAM 市场的重要竞争者,也是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。公司于 2019 年 9 月推出

自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。基于 Omdia 全球厂商 2025 年第四季度 DRAM 销售额统计，凭借不断优化的产品结构、持续迭代的工艺水平、日臻成熟的运营能力以及广泛的市场认可，长鑫科技的全球市场份额已增至 7.67%，位列全球第四位，中国第一位。

(5) 发行人及所处行业具备较强的成长性

作为数字经济时代新型信息基础设施的核心组成部分，DRAM 在现代信息社会中扮演着战略性基础设施的重要角色，是全球半导体市场占比最高的单一品类之一。根据世界半导体贸易统计协会 WSTS 统计，2025 年全球集成电路市场规模为 7,009 亿美元，占半导体产业整体规模的比例约为 88%，其中，全球存储芯片市场规模为 2,300 亿美元，占集成电路市场规模的比例约为 33%。根据 Omdia 和 WSTS 数据，DRAM 是市场规模最大的存储芯片，2025 年全球 DRAM 市场规模为 1,505 亿美元，占存储芯片市场规模的比例约为 65%。

近年来，新兴技术场景持续涌现，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求驱动全球 DRAM 市场规模快速扩大。长期来看，全球 DRAM 市场仍有广阔的增长空间。根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2025 年的 1,505 亿美元增长至 2030 年的 5,710 亿美元，年均复合增长率为 30.56%。

中国 DRAM 市场覆盖国内消费电子市场与电子信息制造业的广泛需求，在全球 DRAM 市场中占据重要份额。根据 Yole 数据，2024 年中国 DRAM 市场规模约为 250 亿美元，占全球 DRAM 市场规模的比重超过四分之一。作为全球主要的 DRAM 需求市场，中国在该领域长期高度依赖进口，DRAM 本土厂商仍有广阔的市场空间。

2、发行人符合科技创新行业领域要求

公司所属科技创新行业领域见下表：

发 行 人 所 属 行	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主要从事 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，是中国领先的 DRAM 研发设计制造一体化企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为“制造业”（C）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	

业 领 域	<input type="checkbox"/> 生物医药	集成电路制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

3、发行人符合科创属性相关指标或情形

科创属性评价指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年，公司研发投入分别为 467,047.07 万元、634,129.13 万元、959,325.46 万元，合计研发投入金额 2,060,501.67 万元，超过 8,000 万元；发行人最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 21.67%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 6,259 人，员工总数为 19,298 人，公司研发人员占比达到 32.43%，研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有境内专利 3,929 件（其中发明专利 3,165 件）、境外专利 3,043 件，并广泛应用于公司主营业务，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年，公司营业收入复合增长率为 160.78%，超过 25%；公司 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，超过 3 亿元

4、发行人符合国家产业政策

公司主要从事 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，所属行业为半导体和集成电路行业，属于《战略性新兴产业分类（2018）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等列示的受国家政策鼓励的产业范围，符合国家产业政策。

（二）保荐人核查情况

1、核查程序

本保荐人履行了如下核查程序：

（1）查阅行业法律法规及国家政策文件，分析公司是否符合国家科技创新战略的相关要求；实地查看公司主要经营场地并了解公司提供的主要产品和服务，对比公司所处行业与相关科创板及战略性新兴产业行业范围；

(2) 向公司管理层及业务人员了解公司所处的行业、主要经营的业务以及相关的行业上下游情况；公司各产品平台核心技术的内容、关键性能指标以及在生产经营中的具体运用等，比较分析公司主要产品关键性能指标与同行业公司同类产品的差异，了解公司技术及产品的先进性；

(3) 向公司管理层及业务人员了解公司先进技术应用形成的产品及产业化情况，公司保持技术不断创新的机制安排，以及技术储备和新技术新产品的商业化情况；

(4) 查阅专业市场分析机构出具的行业分析报告，了解公司在各主营业务领域的行业地位和市场认可度，以及公司所处行业的市场规模、未来市场空间、下游应用领域发展趋势等；

(5) 获取公司参与的重要科研项目的相关凭证，及获得的重要奖项凭证等；

(6) 获取并审阅德勤出具的审计报告，获取并复核公司的研发投入归集明细情况，计算公司研发投入占比；

(7) 获取并了解公司研发部门设置情况及研发人员花名册；

(8) 获取并核查公司的专利注册证书，在裁判文书网、中国执行信息公开网检索公司涉及的诉讼等纠纷，向公司相关研发技术人员了解公司发明专利在主营业务及核心技术中的应用情况。

2、核查结论

经核查，本保荐人认为：发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创板定位要求，发行人符合国家产业政策的相关要求。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

(一) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

保荐人对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《注册管理

办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、发行人的设立及持续经营时间

发行人前身合肥智聚成立于 2016 年 6 月 13 日。2023 年 6 月 27 日，发行人由睿力集成按原账面净资产折股整体变更设立股份有限公司，是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人财务规范情况

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制情况

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人资产完整性及业务、人员、财务、机构独立情况

发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立。公司无控股股东、无实际控制人，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司构成同业竞争的情况。截至本上市保荐书出具之日，发行人与持有公司 5% 以上股份的主要股东及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第一款的规定。

5、业务、控制权及管理团队的稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年无实际控

制人情形没有发生变更，符合《注册管理办法》第十二条第二款的规定。

6、资产权属情况

发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第三款的规定。

7、发行人经营合法合规性

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8、发行人、控股股东及实际控制人的守法情况

发行人无控股股东、无实际控制人。最近三年内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9、董事、高级管理人员的守法情况

发行人董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，发行人不设监事会或者监事。发行人董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

经核查，发行人符合中国证监会《注册管理办法》规定的发行条件。

（二）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

本次发行前，发行人总股本为 6,019,279.75 万股，本次拟公开发行股份不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，每股面值为人民币 1 元，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行

后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

（三）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

本次发行前，发行人股本总额为 6,019,279.75 万元，超过人民币 4 亿元，本次拟公开发行股份不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，符合《上市规则》第 2.1.1 条“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上”的规定。

（四）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

公司选择的具体上市标准为《上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准，即，“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

发行人 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司的估值情况，发行人预计将满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准。

（五）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，保荐人认为：本次证券上市符合《上市规则》规定的上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐人及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

持续督导事项	工作计划
1、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告，关注新闻媒体涉及发行人的报道，督导发行人履行信息披露义务
2、督导发行人有效执行并完善防止关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行
3、督导发行人有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（草案）》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程（草案）》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见；发行人因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人参会并提出意见和建议
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程（草案）》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定
7、中国证监会、证券交易所及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上交所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 汪鹏飞

汪鹏飞

保荐代表人签名: 董军峰 廖小龙

董军峰

廖小龙

内核负责人签名: 徐子桐

徐子桐

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 刘成

刘成

